# IQC 檢驗重點

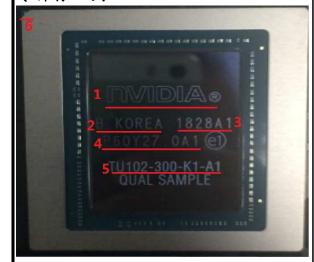
料號

10HB5-140D18-50R

品名規格

CHIP TU102-300-K1-A1 NVIDIA SMD FBGA2824 GB4-384

### 零件樣品圖:





## 外觀文字面檢驗重點:

請指出何者可變動CHANGEABLE(藍色),何者不可變動 UNCHANGEABLE(紅色),並附加說明代表意義

- 1. NVIDIA: Company name (不可變)
- 2. A/B/S: Single alpha assembly plant identifier(不可變)
  - -A = ASE
  - -B= Amkor K5
  - -K= Amkor K4
  - -R=ATT
  - -S= SPIL
  - -T=TSMC

TAIWAN or KOREA or TW or KR: Country of origin(不可變)

-Taiwan: ASE, ATT, SPIL, TSMC

-Korea: Amkor K4 and Amkor K5

3.1828: Assembly date code(可變)

A1: Mask revision(不可變)

- 4. P60Y2770A1: Assembly lot number(可變)
  - -P=TSMC Fab 14(不可變)
- 5.TU102-300-K1-A1: Product Part Number(不可變)
- 6. PIN 1(不可變)
- 7. 二維碼

:Green Code(可變)

QUAL SAMPLE:樣品會有,量產品不會有

#### 機構尺寸工程圖:

2824-ball BGA, 47.5 mm X 47.5 mm(GB4-384)

#### IQC電氣、機構檢驗重點:

- 1. 量測各部尺寸須與規格值相符.
- 2. 檢視產品外觀,表面無異物,且不得有任何破損及變形.

#### μ-EDX 有害物質檢測:

μ-EDX 需依照HCSR 有害物質管制規範實施檢測,並參照IQC EDX Test Guide 規範。

Date: 2018/08/30	Rev. 00	首次發行
Date: 2018/09/04	Rev. 01	將封裝廠S,二維碼料件加入允收規範
Date: 2020/05/13	Rev. 02	將產地TW&KR加入允收規範